

2026-2031年中国智驾芯片行业全景调研及发展前景预测研究报告

报告简介

智驾芯片行业是汽车半导体的核心细分赛道，是面向智能驾驶场景开发的专用计算芯片产业，产品以车规级 SoC

为主体，承担传感器数据接收融合、环境感知、路径规划、车辆决策输出等核心任务，需要满足汽车严苛的可靠性、功能安全标准，广泛适配不同等级的辅助驾驶与高阶自动驾驶车型。完整产业链上游覆盖 IP 核、半导体制造、车规外设元器件，中游包含芯片设计、IP 集成、芯片验证，下游对接整车企业、域控制器厂商，是汽车产业向智能化转型的硬件大脑，芯片的性能、安全与软件生态直接决定整车智能驾驶功能的落地效果，也是国内汽车半导体自主化的关键攻坚领域。

当前国内智驾芯片行业处于技术迭代与规模化量产并行的发展阶段，市场参与主体多元，包含国际半导体厂商、国内第三方芯片设计企业、整车自研芯片团队，不同主体在算力架构、车规验证经验、软件工具链、车企客户资源层面形成明显分化。汽车电子电气架构不断迭代，高阶智驾功能逐步向更大范围车型渗透，但行业发展同时面临车规认证周期长、软件生态建设难度大、产品迭代速度快等现实约束，市场格局伴随车型定点、项目量产持续演变，产业竞争已经不局限于硬件算力指标，软硬件一体化交付能力成为企业核心竞争力。未来，国内智驾芯片行业将迎来技术路线收敛、商业化落地加速的关键周期，行业发展重心由单纯比拼峰值算力，转向舱驾融合架构优化、端侧大模型适配、车规安全体系完善等高价值方向。整车智能化下沉、高阶自动驾驶探索持续拉动芯片需求，车企自研与第三方芯片供应两种模式并行发展，国产芯片的市场应用场景持续拓宽，下游整车选型策略、汽车半导体供应链格局变化，会持续重塑行业竞争态势，对企业的技术路线研判、车规质量管控、软硬件协同开发能力提出更高要求。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、

全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网、全国及海外相关报刊杂志的基础信息以及智驾芯片行业研究单位等公布和提供的大量资料。报告对我国智驾芯片行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外智驾芯片行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了智驾芯片行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。报告对于智驾芯片产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国智驾芯片行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。

本报告也可以用于专精特新“小巨人”申请申报。

报告目录

第一章 智驾芯片行业基础概述

第一节 行业基本界定

一、智驾芯片概念定义

二、智驾芯片产品分类

三、报告研究边界与范围

第二节 行业技术指标体系

一、算力指标维度

二、车规可靠性指标

三、功能安全相关指标

第三节 报告研究方法数据来源

一、调研研究方法

二、数据统计口径说明

三、预测模型说明

第二章 智驾芯片行业产业链完整解析

第一节 产业链整体架构

一、上游环节构成

二、中游环节构成

三、下游应用环节构成

第二节 上游产业链分析

一、ip核供应板块

二、eda工具板块

三、晶圆制造与封测板块

第三节 中游产业链分析

一、芯片设计环节

二、芯片验证环节

三、芯片测试环节

第四节 下游产业链分析

一、域控制器集成环节

二、整车装配环节

三、终端应用场景环节

第三章 2024-2026年年中国智驾芯片行业市场现状

第一节 行业供给现状

一、行业供给总量分析

二、供给结构特征分析

三、供给端竞争格局现状

第二节 行业需求现状

一、整体需求规模分析

二、需求结构拆分分析

三、下游需求变化特征

第三节 行业供需匹配特征

一、供需错配表现

二、结构性供需差异

三、供需动态演化特征

第四章 2024-2026年中国智驾芯片市场规模及增长分析

第一节 整体市场规模

一、市场营收规模统计

二、市场出货量规模统计

三、市场同比增速变化

第二节 细分维度市场规模

一、按算力区间市场规模

二、按自动驾驶等级市场规模

三、按产品类型市场规模

第三节 市场集中度测算

一、cr3市场占比测算

二、cr5市场占比测算

三、市场竞争分层特征

第五章 智驾芯片细分产品市场分析

第一节 低阶辅助驾驶芯片市场

- 一、市场规模现状
- 二、产品性能特征
- 三、市场需求变化特点

第二节 高阶自动驾驶soc芯片市场

- 一、市场规模现状
- 二、产品性能特征
- 三、市场需求变化特点

第三节 舱驾融合一体化芯片市场

- 一、市场规模现状
- 二、产品性能特征
- 三、市场需求变化特点

第四节 智驾mcu功能安全芯片市场

- 一、市场规模现状
- 二、产品性能特征
- 三、市场需求变化特点

第六章 智驾芯片下游应用市场分析

第一节 乘用车领域智驾芯片应用

- 一、不同级别乘用车应用规模
- 二、不同价位段车型应用分布
- 三、乘用车领域渗透水平

第二节 商用车领域智驾芯片应用

一、重卡领域应用情况

二、客车领域应用情况

三、专用车辆应用情况

第三节 其他移动载体应用场景

一、无人配送载体应用

二、场内作业载体应用

三、其他特种载体应用

第七章 智驾芯片行业技术发展现状

第一节 芯片硬件架构技术

一、异构计算架构发展现状

二、chiplet芯粒技术应用现状

三、车规制程工艺发展现状

第二节 算力与能效技术

一、算力迭代演进现状

二、功耗控制技术现状

三、算力能效比发展现状

第三节 软硬协同技术体系

一、底层驱动适配技术

二、大模型车端推理技术

三、功能安全软硬件协同技术

第八章 智驾芯片技术路线对比分析

第一节 不同算力路线对比

一、大算力单芯片路线

二、多芯片组合算力路线

三、算力分配差异化对比

第二节 架构设计路线对比

一、专用npu优先路线

二、通用异构计算路线

三、舱驾合一集成路线

第三节 迭代演进路线预判

一、硬件迭代路径

二、软件迭代路径

三、软硬协同迭代路径

第九章 智驾芯片行业竞争格局分析

第一节 市场竞争总体格局

一、市场参与者类型划分

二、市场竞争分层情况

三、市场竞争演化特征

第二节 按产品维度竞争格局

一、低算力产品竞争格局

二、中算力产品竞争格局

三、高算力产品竞争格局

第三节 竞争关键要素分析

一、性能竞争要素

二、成本竞争要素

三、量产交付竞争要素

第十章 智驾芯片供应链风险与影响分析

第一节 上游供应链风险点

一、ip核供应风险

二、晶圆代工产能风险

三、封测环节供给风险

第二节 供应链成本波动分析

一、晶圆制造成本波动

二、核心物料成本波动

三、综合成本传导路径

第三节 供应链优化发展方向

一、多源供应布局方向

二、本土供应链建设方向

三、供应链风险管控方向

第十一章 2026-2031年中国智驾芯片行业市场预测

第一节 整体市场规模预测

一、2026-2031年营收规模预测

二、2026-2031年出货量规模预测

三、年均复合增速测算

第二节 细分产品市场预测

一、低阶智驾芯片市场预测

二、高阶soc芯片市场预测

三、舱驾融合芯片市场预测

第三节 下游应用市场预测

一、乘用车市场需求预测

二、商用车市场需求预测

三、其他载体需求预测

第十二章 2026-2031年行业技术发展趋势预判

第一节 硬件技术发展趋势

一、制程工艺演进趋势

二、chiplet规模化应用趋势

三、算力能效持续提升趋势

第二节 软件技术发展趋势

一、车端大模型推理普及趋势

二、软硬解耦技术发展趋势

三、功能安全标准化演进趋势

第三节 产品形态发展趋势

一、舱驾深度融合趋势

二、中央计算芯片演进趋势

三、专用功能芯片分化趋势

第十三章 智驾芯片行业驱动因素与制约因素

第一节 行业核心驱动因素

一、下游整车智能化渗透率提升

二、电子电气架构迭代升级

三、算法模型迭代拉动算力需求

第二节 行业主要制约因素

一、车规级验证周期长约束

二、研发投入门槛高约束

三、供应链供给约束

第三节 行业发展机遇分析

一、国产替代市场机遇

二、高阶智驾落地带来增量机遇

三、舱驾融合带来产品迭代机遇

第十四章 智驾芯片行业进入壁垒分析

第一节 技术研发壁垒

一、芯片架构研发壁垒

二、车规功能安全技术壁垒

三、软硬协同开发壁垒

第二节 量产验证壁垒

一、车规认证周期壁垒

二、大规模量产一致性壁垒

三、整车适配验证壁垒

第三节 资金与人才壁垒

一、持续高额研发资金壁垒

二、复合型专业人才壁垒

三、供应链资源壁垒

第十五章 行业重点企业深度分析

第一节 地平线

一、企业概况

二、产品与经营业务分析

三、竞争优势与市场地位

四、企业最新发展动态

第二节 黑芝麻智能

一、企业概况

二、产品与经营业务分析

三、竞争优势与市场地位

四、企业最新发展动态

第三节 芯驰科技

一、企业概况

二、产品与经营业务分析

三、竞争优势与市场地位

四、企业最新发展动态

第四节 爱芯元智

一、企业概况

二、产品与经营业务分析

三、竞争优势与市场地位

四、企业最新发展动态

第五节 芯擎科技

- 一、企业概况
- 二、产品与经营业务分析
- 三、竞争优势与市场地位
- 四、企业最新发展动态

第六节 沐曦集成电路

- 一、企业概况
- 二、产品与经营业务分析
- 三、竞争优势与市场地位
- 四、企业最新发展动态

第七节 华为海思半导体

- 一、企业概况
- 二、产品与经营业务分析
- 三、竞争优势与市场地位
- 四、企业最新发展动态

第八节 英伟达中国区

- 一、企业概况
- 二、产品与经营业务分析
- 三、竞争优势与市场地位
- 四、企业最新发展动态

第九节 mobileye中国

- 一、企业概况

二、产品与经营业务分析

三、竞争优势与市场地位

四、企业最新发展动态

第十节 新芯航途

一、企业概况

二、产品与经营业务分析

三、竞争优势与市场地位

四、企业最新发展动态

第十六章 2026-2031年智驾芯片行业投资机会研判

第一节 产业链各环节投资机会

一、上游核心环节投资机会

二、中游芯片设计环节投资机会

三、下游配套环节投资机会

第二节 细分赛道投资机会

一、大算力智驾芯片赛道机会

二、舱驾融合芯片赛道机会

三、功能安全芯片赛道机会

第三节 投资风险提示

一、技术迭代风险

二、市场需求不及预期风险

三、供应链波动风险

第十七章 2026-2031年行业发展策略建议

第一节 芯片设计企业发展策略

一、技术迭代策略

二、产品布局策略

三、量产适配策略

第二节 下游配套企业策略

一、芯片选型策略

二、软硬件协同策略

三、供应链布局策略

第三节 产业生态构建策略

一、产学研协同策略

二、产业链协同策略

三、人才体系建设策略

图表目录

图表：智驾芯片主要产品分类

图表：智驾芯片关键技术指标对照

图表：2023-2025年中国智驾芯片市场规模统计

图表：2023-2025年中国智驾芯片出货量统计

图表：2023-2025年智驾芯片市场集中度cr3/cr5统计

图表：2026-2031中国智驾芯片市场规模预测

图表：2026-2031中国智驾芯片出货量预测

图表：细分智驾芯片产品市场规模预测

图表：智驾芯片完整产业链结构

图表：2024-2026年中国智驾芯片市场规模变化趋势

图表：2024-2026年智驾芯片细分产品市场占比结构

图表：智驾芯片算力迭代演进趋势

图表：智驾芯片下游应用结构占比

图表：2026-2031中国智驾芯片市场规模预测趋势

图表：智驾芯片市场竞争格局

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

报告编号：4069442

本文地址：<https://www.51baogao.cn/baogao/20260828/4069442.shtml>

在线订购：[点击这里](#)